



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR4 SO DIMM Sockets



DRAM 类型: 小型 (SO)

堆叠高度: 4 mm [.157 in]

模块方向: 直角

位数: 260

中心线 (间距) : .5 mm [.02 in]

[所有 DDR4 SO DIMM Sockets \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板   |
| 连接器系统     | 缆到板     |
| DRAM 类型   | 小型 (SO) |

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 钥匙数  | 1   |
| 行数   | 2   |
| 模块方向 | 直角  |
| 位数   | 260 |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| DRAM 电压 | 1.2 V |
|---------|-------|

信号特征

|          |       |
|----------|-------|
| SGRAM 电压 | 1.2 V |
|----------|-------|

主体特性

|       |        |
|-------|--------|
| 固定柱位置 | 两端     |
| 插销材料  | 高温热塑塑料 |
|       |        |



|        |     |
|--------|-----|
| 模块钥匙类型 | 左偏移 |
| 弹射器类型  | 锁定  |
| 弹射器位置  | 两端  |
| 连接器外形  | 低   |

接触件特性

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子额定电流（最大值）    | .5 A            |
| 内存插槽类型         | 内存卡             |
| 端子基材           | 铜合金             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金              |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)          |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .254 μm[10 μin] |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| 插入种类     | 凸轮   |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 连接器安装类型    | 板安装  |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉   |
| 接合对准类型     | 标准键控 |
| PCB 安装固定   | 带有   |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | 高温热塑塑料        |
| 壳体颜色    | 黑色            |
| 中心线（间距） | .5 mm[.02 in] |

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 堆叠高度 | 4 mm[.157 in]   |
| 行间距  | 8.2 mm[.322 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|



包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 900  |
| 封装方法 | 卷带包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)



[DIMM 插槽\(25\)](#)



[SO DIMM 插槽\(39\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号5-146276-8  
[08 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)



TE 产品编号2309411-3  
[DDR4 SODIMM 260P 8.0H STD](#)



TE 产品编号3-6318490-6  
[.5FHR04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)



TE 产品编号2007722-1  
[IMP100S,R,RA4P16C,RG,39](#)



TE 产品编号1827236-4  
[SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4](#)



TE 产品编号5-146276-2  
[02 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)



TE 产品编号2007831-3  
[IMP100S,H,V4P16C,RG,LEW39,5.5](#)



TE 产品编号292336-1  
[Std USB Type A, Flag, T/H](#)



TE 产品编号2007710-1  
[IMP100S,R,RA3P16C,RG,39](#)



TE 产品编号2299805-1  
[NRW BACK PLATE ASSY,SOCKET P0, STUD6.8MM](#)

文档

[DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD](#)

[英文版本](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309407-3\\_1.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309407-3\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309407-3\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本